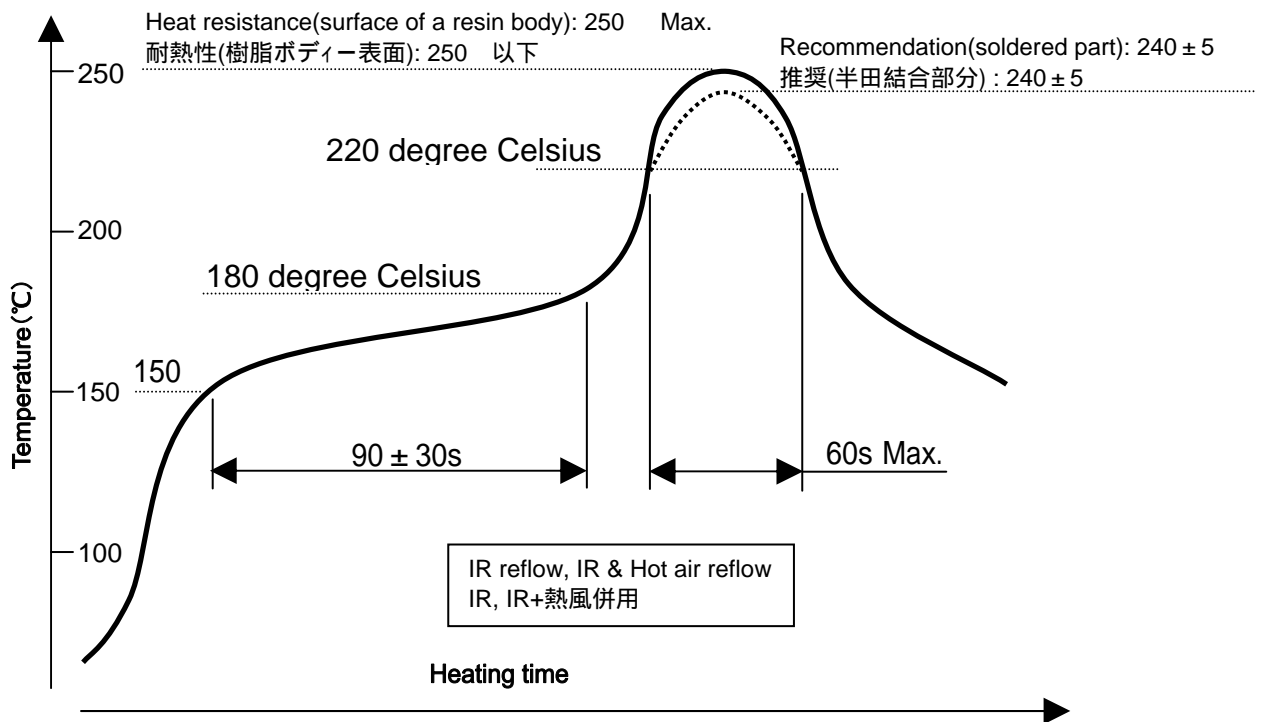


【Heat-resistant and Recommended temperature profile of reflow soldering】
【リフロー耐熱温度プロファイル / 推奨リフロー温度プロファイル】

Preheating temperature		150 to 180	90 ± 30s
Main heating temperature		220 or more	60s Max.
Peak temperature	Heat resistance	250 Max	10s Max.
	Recommendation	240 ± 5	10s Max.
Number of reflows		2 cycles or less	

予備加熱		150 ~ 180	90 ± 30s
本加熱		220 以上	60s 以下
ピーク温度	耐熱性	250 以下	10s 以下
	推奨	240 ± 5	10s 以下
リフロー回数		2 回以下	



Note: As this reflow conditions varies in the reflow facility and PCB, please conduct the evaluation of your reflow conditions before manufacturing.

注：本リフロー条件に関しては、リフロー装置及び基板等により条件が異なりますので、事前に実装評価をお願い致します。